FANLESS EMBEDDED COMPUTERS

Titan 300 TGL-UP3

第11世代Intel® コア™とIntel® Celeron® SoCs（コードネーム:Tiger LakeUP3）

第11世代Intel®コア™搭載の堅牢な産業用ボックスPC



ハイライト

CPU
第11世代Intel® コア™プロセッサとIntel® Celeron® プロセッサ

コネクティビティ
2x 2.5 GbE、オプションのM.2 WWANとWLANモジュール

グラフィックス
最大96のEUのIntel® Iris® Xeアーキテクチャ、最大4つの独立したディスプレイ

メモリ
IBECCでDDR4-3200 ECC メモリをサポートする二つのDDR4 SO-DIMM スロット

Windows 10 IoT Enterprise　Linux　yocto PROJECT

主な適用分野

コーヒーと自販機　メディカル　安全と監視　産業オートメーション　スマートデバイス　エネルギーユーティリティ

特徴

プロセッサ	**Intel® コア™ i7-1185G7E**、クアッドコア@ 2.8GHz（4.4GHzターボブースト）、12MBキャッシュ、28W TDP（12W cTDP）、Hyperthreading搭載 **Intel® コア™ i5-1145G7E**、クアッドコア@ 2.6GHz（4.1GHzターボブースト）、8MBキャッシュ、28W TDP（12W cTDP） **Intel® コア™ i3-1115G4E**、デュアルコア@ 3.0GHz（3.9GHzターボブースト）、6MBキャッシュ、28W TDP（12W cTDP） **Intel® Celeron® 6305E**E、デュアルコア@ 1.8GHz、4MBキャッシュ、15W TDP **Intel® コア™ i7-1185GRE**、クアッドコア@ 2.8GHz（4.4GHzターボブースト）、12MBキャッシュ、IBECC、28W TDP（12W cTDP） - 搭載 - 産業用 **ンテル® コア™ i5-1145GRE**、クアッドコア@ 2.6GHz（4.1GHzターボブースト）、8MBキャッシュ、IBECC、28W TDP（12W cTDP）、Hyperthreading搭載 - 産業用 **Intel® コア™ i3-1115GRE**、デュアルコア@ 3.0GHz（3.9GHzターボブースト）、6MBキャッシュ、IBECC、28W TDP（12W cTDP） - 産業用
メモリ	2x DDR4-3200 SODIMMスロット 最大64GB（IBECCはコア™産業用SoCでのみサポート）
グラフィック	最大2つの動画デコードボックス（VDBox）により、動画ストリーム機能を強化 最大4K60 HDR解像度で最大4台の独立したディスプレイ、または8K解像度で1台のディスプレイをサポート
動画インターフェース	2x マルチモードDisplayPort 1.4、デュアルDP++コネクター 2x USB Type-Cコネクタのマルチモード Display Port 1.4（代替モード）
動画解像度	DP：　DSCで最大5120x3200 @60Hz 24bpp / 7680x4320@60Hz 30bpp HDMI® 1.4：　最大4Kx2K 24-30Hz 24bpp
質量ストレージ	オンボードNMVeドライブ、最大2モジュール、最大1TBのグローバル容量

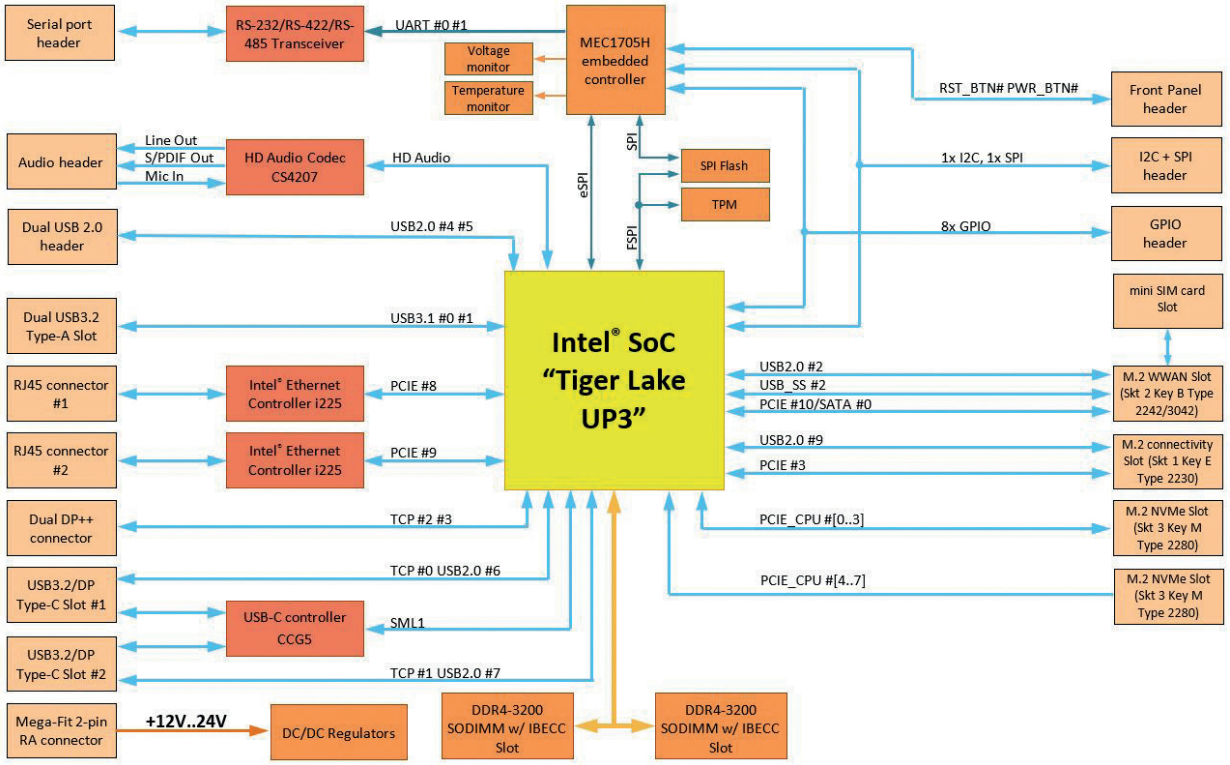
ネットワーキング	2.5ギガビットイーサネットRJ45コネクター×2基 オプションのオンボードM.2 Wi-Fi（802.11ac/a/b/g/n）＋BT 5.0モジュール、ダイポールアンテナ付属* オプションのオンボードM.2 LTEモデム、Mini-SIMスロット付き、ダイポールアンテナ付き* *ご要望に応じて認証
USB	デュアルType-Aソケットの2xスーパースピードUSB 10Gbpsポート USB タイプ-Cスロットに2x Superspeed USB 20Gbps
シリアルポート	2x RS-232/RS-422/RS-485 UARTSソフトウェア設定可能、DB9コネクタ
オーディオ	ラインアウト＋マイク入力コンボTRRSオーディオジャック
その他インターフェース	オプションで、以下のI/Oを備えた2x 12極ターミナルブロックコネクター： 8x GPIOs 1x I2C 1x SPI 1x 5V 1x 3.3V 1x 12V 3x GND 電源ONボタン オプションTPM 1.2/2.0 モジュールオンボード
電源供給	12_{VDC} ～ $_{24}$VDCレンジ、メガフィット2p RAコネクタ オンボードRTC用コイン電池
動作システム	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Linux（カーネル≥5.4バージョン）
動作温度	商用範囲： 0° C～+40° C、気流0.7m/sの場合** 範囲を拡大： -30° C～+40° C、0.7m/sの気流** **CPUのTDPを縮小した場合、最大60° C
寸法	199×174×73mm（7.83インチ×6.85インチ×2.87インチ） DINレールまたは壁掛けブラケット（工場出荷時の代替品）

情報は変更されることがあります。このデータシートの最新版は www.edge.seco.com をご覧ください

Titan 300 TGL-UP3

第11世代Intel® コア™とIntel® Celeron® SoCs（コードネーム:Tiger LakeUP3）

ブロック図



情報は変更されることがあります。このデータシートの最新版は www.edge.seco.com をご覧ください
298.23

エッジコンピューティングの実装を合理化し、迅速化します

エッジホッグOS

カスタマイズツールとDockerのサポートにより、ニーズに適応する柔軟なオペレーティングシステムです。信頼性とセキュリティは、デュアルパーティションシステムとExeinの堅牢なAIベースの保護とのネイティブ統合によって組み込まれています。

デバイスマネージャー

更新、設定、またリモートデバイスを管理します。コストのかかる現場介入を必要とせずに、運用効率とセキュリティを最大化するために時間とコストを最適化します。

データオーケストレーション

サードパーティのサービスを統合し、データフローと分析を簡素化し、AI を簡単かつ迅速に利用できるようにするのでビジネス効率を高めます。

ポータル

リモートデバイスからのデータを分析し、ユーザーのニーズに合わせたアプリケーションでユーザーエクスペリエンスをカスタマイズし、ユーザー権限、企業アクセス、テナント権限を管理します。



スキャンして詳細を確認してください
ソリューション

エッジホッグOS

CLEA DOCS

情報は変更されることがあります。このデータシートの最新版は www.edge.seco.com をご覧ください